



小华半导体有限公司名称及 LOGO 变更的通知

| | | | |
|------|-----|-----|----|
| 客户名称 | ALL | 联系人 | NA |
|------|-----|-----|----|

| | | |
|-------|------|------|
| 受影响产品 | 商业名称 | 物料编码 |
| | All | All |

| 变更原因描述 | 原“华大半导体有限公司 MCU 事业部”已于 2021 年 11 月 26 日独立成“小华半导体有限公司”，此变更涉及公司名称和公司 LOGO 的变化，需更新产品包装标签和包装盒（箱）的 LOGO，对外文档及开发工具。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 变更方法描述 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产品商业型号 | 产品商业型号保持原规则，不做变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产品表面丝印 | <p>1. 正面的丝印 LOGO 为 HDSC;</p> <p>2. D/C 为 YYMMDDV。</p>  | <p>1. 已量产出货的产品丝印 LOGO 保持不变，包含如下产品系列：</p> <table border="1" data-bbox="925 1075 1436 1400"> <thead> <tr> <th colspan="3">通用型号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HC16LC16XX</td><td>HC32L072XX</td><td>HC32F190XX</td></tr> <tr><td>HC32A136XX</td><td>HC32L073XX</td><td>HC32F196XX</td></tr> <tr><td>HC32A460XX</td><td>HC32L110XX</td><td>HC32L170XX</td></tr> <tr><td>HC32D390XX</td><td>HC32L130XX</td><td>HC32L176XX</td></tr> <tr><td>HC32D391XX</td><td>HC32L136XX</td><td>HC32L190XX</td></tr> <tr><td>HC32F002XX</td><td>HC32F030XX</td><td>HC32L196XX</td></tr> <tr><td>HC32F003XX</td><td>HC32F072XX</td><td>HC32M120XX</td></tr> <tr><td>HC32F005XX</td><td>HC32F120XX</td><td>HC32M140XX</td></tr> <tr><td>HC32F460XX</td><td>HC32F146XX</td><td>HC32M423XX</td></tr> <tr><td>HC32F4A0XX</td><td>HC32F170XX</td><td>HCM3043XX</td></tr> <tr><td>HC32L051XX</td><td>HC32F176XX</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>2. 2021 年 12 月 31 后投放市场的新产品，丝印上如有 LOGO 的将变更为 XHSC；D/C 由 YYMMDD 变更为 YYWW+2 码 Trace code。</p>  | 通用型号 | | | HC16LC16XX | HC32L072XX | HC32F190XX | HC32A136XX | HC32L073XX | HC32F196XX | HC32A460XX | HC32L110XX | HC32L170XX | HC32D390XX | HC32L130XX | HC32L176XX | HC32D391XX | HC32L136XX | HC32L190XX | HC32F002XX | HC32F030XX | HC32L196XX | HC32F003XX | HC32F072XX | HC32M120XX | HC32F005XX | HC32F120XX | HC32M140XX | HC32F460XX | HC32F146XX | HC32M423XX | HC32F4A0XX | HC32F170XX | HCM3043XX | HC32L051XX | HC32F176XX |
| 通用型号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC16LC16XX | HC32L072XX | HC32F190XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32A136XX | HC32L073XX | HC32F196XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32A460XX | HC32L110XX | HC32L170XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32D390XX | HC32L130XX | HC32L176XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32D391XX | HC32L136XX | HC32L190XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32F002XX | HC32F030XX | HC32L196XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32F003XX | HC32F072XX | HC32M120XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32F005XX | HC32F120XX | HC32M140XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32F460XX | HC32F146XX | HC32M423XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32F4A0XX | HC32F170XX | HCM3043XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HC32L051XX | HC32F176XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 包装箱印刷标签 | 1. 将原包装盒及包装箱印刷的“华大半导体有限公司 LOGO”变更为“小华半导体有限公司 LOGO”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|---|---|
| 企业名称 | 华大半导体有限公司 | 小华半导体有限公司 |
| 企业Logo |  |  |

2. 将产品标签上印刷的“华大半导体有限公司 LOGO+公司名称”变更为“小华半导体有限公司 LOGO+公司名称”，同时对标签模板进行排版优化，具体如下：

| | |
|---|---|
| <p>➤ 现有标签模板</p> <p>• 内包装及内盒</p>  | <p>• 外箱</p>  |
| <p>➤ 新标签模板（内外包装共用模板）</p>  | <p>➤ 标签模板变更说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更换logo+公司名称：“华大Logo”改为“小华Logo” 2. Lot改为Wafer Lot, MFG Lot改为MFG No., 避免客户混淆 3. 字体变更：由宋体改为Arial, 字符打印更清晰美观 4. 优化排版：条形码与内容对齐 5. 内标签增加产地信息 6. 内标签增加包装时间 7. 统一标签尺寸为100mm x 50mm 8. Q' ty改成QTY: 减少占用字符长度 9. 增加work order缩写W/O, 便于标签信息说明 |

3. 当外箱内包含多个 MFG No.时, 则外箱会粘贴每个 MFG No.的标签。
 4. 对已经包装入库的产品不做变更, 新老包装随机出货。在新老包装变更过渡期间, 会存在包装和标签上小华和华大 LOGO 交替出现的情况, 例如标签是小华 LOGO, 包装箱是华大 LOGO。

| | | |
|-----------------|---|--|
| 数据手册、用户手册、AN、勘误 | 公司中文名称：华大半导体有限公司 公司英文名称：Huada Semiconductor Co.,Ltd 公司网址：www.hdsc.com.cn 公司名称缩写：HDSC LOGO:  | 公司中文名称：小华半导体有限公司 公司英文名称：Xiaohua Semiconductor Co.,Ltd 公司网址：www.xhsc.com.cn 公司名称缩写：XHSC LOGO:  |
| 开发套件 | 公司中文名称：华大半导体有限公司 公司英文名称：Huada Semiconductor Co.,Ltd 公司网址：www.hdsc.com.cn 公司名称缩写：HDSC | 公司中文名称：小华半导体有限公司 公司英文名称：Xiaohua Semiconductor Co.,Ltd 公司网址：www.xhsc.com.cn 公司名称缩写：XHSC |
| 驱动程序和工具 | 公司中文名称：华大半导体有限公司 公司英文名称：Huada Semiconductor | 公司中文名称：小华半导体有限公司 公司英文名称：Xiaohua Semiconductor |



| | | |
|---|---|--|
| | Co.,Ltd 公司网址: www.hdsc.com.cn 公司名称缩写: HDSC LOGO:  | Co.,Ltd 公司网址: www.xhsc.com.cn 公司名称缩写: XHSC LOGO:  |
| 硬件开发板 STK/EVB | 公司网址: www.hdsc.com.cn LOGO:  | 公司网址: www.xhsc.com.cn LOGO:  |
| 编程器外壳, PCB板丝印, 包装纸盒 | 公司中文名称: 华大半导体有限公司 公司英文名称: Huada Semiconductor Co.,Ltd 公司名称缩写: HDSC LOGO:  | 公司中文名称: 小华半导体有限公司 公司英文名称: Xiaohua Semiconductor Co.,Ltd 公司名称缩写: XHSC LOGO:  |
| 官方网站 | www.hdsc.com.cn | www.xhsc.com.cn (预期2月份正式上线) |
| 变更生效日期或产品 Date Code 说明: 从 2022 年 2 月 28 日开始陆续切换 | | |

发行人 马永新 发行日期 2022/1/19
 工程运营副总经理签署:   日期: 2022.1.25

客户 部确认意见:
 签署: 日期:

✎ 以上, 特此通知, 如果您有任何意见或建议, 请随时与我司销售部门联系。✎